

프로그래밍 가능한 P-T-T 제어 기능을 갖춘 25톤 200X200Mm 진공 핫 프레스

품목 번호: XP26



소개

이 25톤 데스크탑 진공 핫 프레스는 까다로운 실험실 응용 분야를 위해 설계되어, 정밀한 P-T-t 동기화, 최대 500°C 온도 범위, 불활성 가스/진공 환경, 적응형 전력 매칭을 제공하여, 고체 전지, 세라믹 및 복합재 연구에서 고밀도 소결 및 접합을 가능하게 합니다. 동적 압력 감소 기능을 갖춘 컴팩트하고 CE 인증을 받은 시스템으로 장기적인 신뢰성을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
고체 전지 연구 개발	황화물/산화물 전해질의 고온 고압 하에서의 고밀도 및 고체-고체 계면 접합.	챔버의 높은 기밀성으로 N ₂ /Ar 하에서 장기간 압력 유지 소결이 가능하여 활성 리튬 산화를 방지합니다.
첨단 세라믹 및 복합재	세라믹 분말 및 비금속 매트릭스 복합재의 무산소 진공 확산 소결.	-0.1 MPa 진공의 SUS304 스테인리스 스틸 챔버가 휘발성 가스를 신속히 제거하여 결함 없는 부품을 생산합니다.
플렉서블 전자 장치 및 MLCC	폴리머 필름 및 다층 세라믹 커패시터의 섬세한 층을 위한 다단계 가열 적층.	100g 정도로 낮은 프로그래밍 가능한 소프트 스타트 압력으로 초기 프레스 중 취성 얇은 시트의 파손을 방지합니다.
금속 확산 접합	고온 진공 하에서 이중 금속/합금의 원자 확산 용접.	고정밀 평행도의 200x200 mm 연마 플래튼이 균일한 응력 분포를 보장하여 공극과 결함을 최소화합니다.
분말 야금 압축	진공 하에서 금속, 세라믹 및 복합재 분말의 고밀도 고형화.	간헐 가스를 제거하고 기공률을 줄이며 기계적 강도와 전기 전도성을 향상시킵니다.

매개변수	표준 구성	프로페셔널/업그레이드 구성
플래튼 크기	200 × 200 mm	-
최대 온도	300 °C (자연 냉각)	500 °C (순환 냉각기 필요)
온도 제어 정확도	≤ 3 °C	≤ 1 °C
최대 가열 속도	≤ 3 °C/min	-
최대 압력 (콜드 상태)	25톤 (250 kN)	-
최대 압력 (핫 상태)	-	15톤 (150 kN) @ 500°C
압력 제어 정확도	±0.1톤 (페루프 피드백)	-
테이라이트 개구	50 mm	100 mm (대형 몰드 적합)
가열 전력	1800 W / 2400 W	3000 W / 3500 W
진공 챔버 크기	-	400 × 400 × 400 mm
챔버 재질	SUS 304 스테인리스 스틸	-

매개변수	표준 구성	프로페셔널/업그레이드 구성
극한 진공도	-0.1 MPa (240 L/min 2단 펌프 사용 시)	-
플래튼 냉각 방식	주변 공기	외부 순환 냉각기
제어 인터페이스	7인치 프로그래밍 가능 PLC 터치스크린	-
전원 공급 옵션	AC 220 V / 50 Hz	AC 110 V / 60 Hz 또는 AC 440 V / 60 Hz
순중량 (대략)	270 kg (구성에 따라 다름)	-
규정 준수	CE 인증	-